116 -0,3

Таблица 1 - Данные отверстий

Условное обозначение отверстий	Диаметры отверстий, мм	Диаметры контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
_	0,3 +0 -0,13	0,6 +0 -0,13	Есть	56
	1,0 +0,1	1,5 ^{+0,1}	Есть	27
	3,0 +0,2	Hem	Hem	4

- 1.* Размеры для справок
- 2. Οδιμυε δοημικώ πο ΓΟΣΤ 30893.1-2002: H12, h12, ±IT 12/2
- 3. Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2-2002 Н
- 4. Шаг координатной сетки 1,25 мм
- 5. Плату изготовить комбинированным позитивным методом
- 6. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 -3:
- минимальная номинальная ширина проводника 0,25 мм;
- минимальное номинальное расстояние между элементами проводящего рисунка 0,25 мм;
- минимальный номинальный диаметр переходного отверстия 0,3 мм.
- 7. Параметры отверстий, контактных площадок платы приведены в таблице 1
- 8. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 3
- 9. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86, контактных зон припоем ПОС -61 ГОСТ 21930-76 толщиной не менее 35 мкм.
- 7. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО .070.014-75

					ИУ 4.11.03.03.22.08.83.11.002					
					Устройство учета	/lum	Масса	Масшта		
Изм.	Лист	N °докум.	Подпись	Дата	,			1 ~ 1		
Разраб .		Кутаев К.С.			электронных компонентов			2:1		
Пров	Вер.	Γлαдκих Α.Α.			,					
Т.контр.					Плата печатная	Лист Листов 1				
Н .контр . Утв .					FR4-DE104	МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра ИУ 4 Группа ИУ 4-83 Б				
					==					
					TY 2296-001-39421663-13					

11epb. npum. MY 4. 11 N3 N3 22 N8 83 11 NN 1

лрав. N °

Инв. N °дубл. Подп. и дата

и дата Взам.инв. N° Инв. N°дубл.

40=

нв. И °подп. Подп. и да

Копировал

1 руппа ИЭ 4-1 Формат А2